

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏艾森半导体材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
审核问询函的回复

上会业函字（2026）第 1158 号

上海证券交易所：

贵所于 2026 年 8 月 26 日下发的“上证科审（再融资）〔2026〕194 号”《关于江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“公司”或“发行人”）与申报会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

问题 1、关于本次募投项目及融资规模

根据申报材料，1) 本次发行拟募集资金总额不超过 51,400 万元，拟用于“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”及补充流动资金，本次募投项目建成后，将形成光刻胶及配套树脂、湿电子化学品 13,000 吨/年的产能规模，并完成一期、二期项目全部土建工程建设。2) 本次募投项目中部分产品尚处于实验室研发阶段、客户端验证或小批量生产阶段。3) “电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”预计税后内部收益率为 30.12%，税后静态投资回收期为 6.84 年。

请发行人说明：（1）公司是否具备实施电子制造关键材料华东研发和制造基地项目一期、二期的营运能力、资金实力，本次募投项目规划是否具有必要性及合理性，是否符合行业趋势，本次募集资金是否符合投向科技创新领域的要求，相关风险揭示是否充分；

（2）结合“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”涉及部分新产品与现有业务的相关性、协同性，说明相关产品的技术、生产程序是否具有可行性，是否已完成中试或达到同等状态，项目实施是否存在重大不确定性；

（3）结合光刻胶、湿电子化学品领域国内外发展状况，本次募投项目产品的市场空间、竞争格局，公司前次募投项目产能利用及盈利情况、公司现有产能利用及产销情况、同行业可比公司同期产能利用情况等，说明本次募投项目产能消化的合理性，是否存在产能消化风险；

（4）本次募投项目中土地购置、建筑工程及安装、设备购置安装费等具体内容及测算依据，各项投资单价或单位产能投资额与公司类似项目或同行业公司可比项目是否存在明显差异；是否涉及置换董事会前投入资金；

（5）结合项目建设期、产销率和产能利用率、具体产品及对应单价等参数，说明“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”内部收益率、投资回收期等指标测算是否审慎，与公司或同行业公司可比项目是否存在明显差异；分析本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销对公司业绩的影响，风险提示是否充分；结合公司定期存款等货币资金余额、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等，说明本次补充流动资金规模的合理性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。请保荐机构及申报会计师根据《证券期货法律适用意见第18号》第5条、《监管规则适用指引—发行类第7号》第5条对问题（5）进行核查并发表明确意见。

回复：

五、结合项目建设期、产销率和产能利用率、具体产品及对应单价等参数，说明“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”内部收益率、投资回收期等指标测算是否审慎，与公司或同行业公司可比项目是否存在明显差异；分析本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销对公司业绩的影响，风险提示是否充分；结合公司定期存款等货币资金余额、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等，说明本次补充流动资金规模的合理性。

（一）结合项目建设期、产销率和产能利用率、具体产品及对应单价等参数，说明“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”内部收益率、投资回收期等指标测算是否审慎，与公司或同行业公司可比项目是否存在明显差异

2026年9月，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等议案，结合公司实际情况更新了本次募投项目的效益测算，相关指标具体分析如下：

1、项目建设期

本项目建设期拟定为2026年7月-2028年9月，约为26个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试运行投产等，具体规划进度情况如下：

序号	内容	进度（月）							
		T	T+4	T+8	T+12	T+16	T+20	T+24	T+26
1	项目前期工作	△	△						
2	施工设计		△	△					
3	土建工程			△	△	△	△		

4	设备安装及调试				△	△	△	△	
5	竣工								△

项目建设周期符合项目建设实际需求，具有合理性。

2、产销率和产能利用率

本次募投项目产品包括光刻胶及配套树脂、湿电子化学品，主要应用于先进封装、集成电路制造等领域，在国内集成电路产业持续扩张及关键材料供应链安全需求提升的背景下，本次募投项目涉及的相关产品具有较为广阔的市场空间。报告期内，随着公司业务的持续拓展，公司产能利用率分别为 50.34%、63.61%、80.86%和 91.92%，现有的产能利用已接近饱和；产销率分别为 93.63%、97.13%、107.00%和 94.20%，各期产销率均在 90%以上，销售情况良好。公司为巩固和扩大市场，及时推进本次募投项目的建设，以提升产品产能，抓住市场机遇，进一步提升在国内外市场的技术优势和市场份额。

在产能利用率方面，公司将充分利用现有的核心技术与运营经验进行生产，具备快速实现本项目涉及产品量产的技术实力，假设项目投产初期相关产品仍在市场拓展阶段，产能利用率随产品销量增长逐步上升，经营期第一年至第七年产能利用率分别为 19%、39%、58%、82%、87%、92%、97%，第七年后达到稳定期。

在产销率方面，结合光刻胶、湿电子化学品领域国内外发展状况，本次募投项目产品的市场空间、竞争格局，公司前次募投项目产能利用及盈利情况、公司现有产能利用及产销情况、同行业可比公司同期产能利用情况等，本项目产品市场空间广阔，公司的产能消化措施清晰可行，结合报告期末公司产能利用率及产销率处于高位且在手订单持续增长的实际情况，募投项目经营期间产销率设置为 100%。

综上所述，本次募投项目预计产销情况以及产能利用率、产销率的预测具有合理性。

3、具体产品及对应单价

本次募投项目涉及产品种类较多，且不同产品工艺及销售价格差距较大，相关产品单价系公司根据市场调研并结合公司拟开发产品定位及销售策略等因素，在报告期内销售价格或市场调研价格基础上进行一定折价后，合理确定为募投项目相关产品预计首年价格。

在后续年度销售价格测算中，发行人基于谨慎性原则，综合考虑公司产品迭代与技术成熟、半导体产业链国产替代进程加速及市场竞争等因素，针对光刻胶类产品及湿电子化学品项下的蚀刻液产品，假设销售价格每年下降 10%，至 2035 年达到稳定期；针对湿电子化学品项下的清洗液产品，由于其技术成熟且规划产能规模较大，假设其在后续年度中首年销售价格下降 30%，此后逐年下降 5%，至 2035 年达到稳定期。

综上所述，发行人单价相关预测系依据市场调研和实际经营情况对未来的合理预测，已充分考虑行业技术迭代与市场竞争等因素，本次募投项目产品价格预测具有谨慎性与合理性。

4、内部收益率、投资回收期等指标测算是否审慎，与公司或同行业公司可比项目是否存在明显差异

通过上述预测数据综合计算，“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”税后投资内部收益率为 28.25%、税后静态投资回收期为 6.94 年。本项目在产能利用率、产品价格等方面的预测均采用谨慎口径，内部收益率、投资回收期等指标测算具有审慎性。由于本项目完全达产后收益主要来源于光刻胶及配套树脂相关产品，因此选择同行业公司光刻胶或树脂类募投项目的内部收益率、投资回收期对比如下：

公司	项目名称	具体产品类型	内部收益率	投资回收期（年）
上海新阳	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	KrF 厚膜光刻胶、ArF 干法光刻胶及配套试剂	24.04%	7.71
鼎龙股份	年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目	KrF、ArF 晶圆光刻胶	19.87%	7.89
容大感光	高端感光线路干膜光刻胶建设项目	高端感光线路干膜产品	19.04%	8.19
彤程新材	60000t/a 橡胶助剂扩建项目	电子级酚醛树脂等	45.53%	4.19
平均值			27.12%	7.00
发行人	电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）	光刻胶及配套树脂、湿电子化学品	28.25%	6.94

由上表可见，“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”内部收益率与投资回收期处于同行业公司可比项目相关指标合理范围内，与行业平均内部收益率27.12%，平均投资回收期为7.00年较为接近，不存在重大差异。

（二）分析本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销对公司业绩的影响，风险提示是否充分

1、分析本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销对公司业绩的影响

本次募投项目的固定资产折旧和无形资产摊销以公司现有会计政策为基础，采用直线法计提折旧摊销。电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）完工后，每期新增的折旧摊销金额对公司经营业绩的影响如下：

单位：万元

项目	运营期 第1年	运营期 第2年	运营期 第3年	运营期 第4年	运营期 第5年	运营期 第6年	稳定期
新增折旧摊销	4,301.32	4,301.32	4,301.32	4,301.32	4,301.32	4,301.32	4,301.32
新增营业收入	34,410.00	53,070.00	77,712.10	107,136.09	133,234.26	159,218.23	172,651.85
新增折旧摊销占新增营业收入比例	12.50%	8.10%	5.53%	4.01%	3.23%	2.70%	2.49%

从短期来看，运营期第一年新增折旧摊销占新增营业收入比例为12.50%，对公司业绩存在一定影响，但随着募投项目产品销量逐步爬坡并趋于稳定，新增营业收入的提升会使得折旧摊销的影响逐步降低；从长远来看，稳定期内新增折旧摊销占新增营业收入比例为2.49%，其占比较低，预计不构成重大不利影响。

针对后续二期项目，由于其计划建设期较远，目前难以准确预测建设及折旧摊销具体情况。根据发行人整体规划，“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”主要将完成土建工程及部分产线的建设，未来二期项目完成研发测试中心及剩余部分产线建设。随着发行人的业务发展及一期项目的逐步投产，相较于一期项目，预计二期项

目新增折旧摊销对公司业绩的影响将进一步降低。因此，预计本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销不会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。

2、相关风险提示是否充分

发行人本次募投项目将在建成后形成规模较大的固定资产及无形资产，并新增较大金额的折旧及摊销费用，发行人已在募集说明书中揭示了本次募投项目新增折旧及摊销影响公司业绩风险；为进一步明确本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销对公司业绩的影响，发行人在募集说明书“第三节 风险因素”之“三、其他风险”之“（一）与本次募集资金投资项目相关的风险”补充披露如下：

“4、募集资金投资项目新增折旧及摊销影响公司业绩风险

本次募集资金投资项目投资规模较大且主要为资本性支出，建成后公司固定资产、无形资产等资产规模将大幅度增加，并新增较大金额的折旧摊销，预计达产后年均新增折旧摊销约 4,301.32 万元。同时，公司远期规划的二期项目建设完成后，折旧摊销金额将进一步增加。若相关项目不能如期达产或者达产后不能达到预期的收益水平，导致项目收益未能覆盖新增的折旧摊销费用，则公司存在因资产折旧摊销增加而导致业绩下滑的风险。”

（三）结合公司定期存款等货币资金余额、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等，说明本次补充流动资金规模的合理性

公司综合考虑定期存款等货币资金余额、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等自身和外部条件，拟将本次募集资金中的 4,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标，具体分析如下：

1、货币资金余额

截至 2026 年 6 月末，公司货币资金余额为 18,371.50 万元，考虑使用受限资金后，公司实际可支配资金低于上述金额，具体如下表所示：

单位：万元

项目	金额
货币资金余额	18,371.50
交易性金融资产余额	-
减：货币资金中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	498.76
减：前次募集资金净额	7,718.56
可自由支配资金余额	10,154.18

截至 2026 年 6 月末，公司可自由支配的资金余额为 10,154.18 万元，定期存款（含利息）余额为 29,414.09 万元。发行人期末货币资金主要用于维持日常运营所需的最低现金保有量。2025 年度，发行人月均经营活动现金流出为 3,669.95 万元，上述可自由支配的资金及定期存款覆盖发行人日常运营支出约 10.78 个月。

2、资产负债结构

报告期各期末，公司资产负债结构如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
资产总额	139,276.62	139,098.22	124,410.57	127,988.91
负债总额	33,817.44	35,635.37	26,600.92	26,364.21
资产负债率	24.28%	25.62%	21.38%	20.60%

报告期内，公司合并口径资产负债率分别为 20.60%、21.38%、25.62%和 24.28%，整体呈上升趋势。在发行人业务规模持续扩大的背景下，本次发行募集资金用于补充流动资金，可以对发行人业务发展提供有力支持，改善发行人的财务结构、提高抗风险能力。

3、未来资金流入及流出情况

2023 年至 2025 年，公司营业收入年复合增长率达到 28.30%。充分考虑公司业务发展、下游市场需求、公司行业地位、未来战略规划等，2026 年至 2028 年预测期公司营业收入增长率按 25.00%估算，预计流动资金缺口为 21,664.81 万元，具体测算如下：

单位：万元

项目	2025A	占营业收入比例	2026E	2027E	2028E
营业收入	59,264.37	-	74,080.46	92,600.58	115,750.72
经营资产合计	30,554.98	51.56%	38,193.72	47,742.16	59,677.69
经营负债合计	7,824.69	13.20%	9,780.86	12,226.08	15,282.60
营运资金占用额	22,730.29	38.35%	28,412.86	35,516.08	44,395.10
流动资金缺口	21,664.81				

注：上述测算仅为测算流动资金缺口，不构成公司未来盈利预测，下同。

2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,107.80 万元，营业收入金额为 59,264.37 万元，当年经营活动现金流量净额占营业收入比重为 13.68%；2026 年上半年，经营活动产生的现金流量净额为 2,225.18 万元，营业收入金额为 34,605.33 万元，当期经营活动现金流量净额占营业收入比重为 6.43%。基于谨慎性原则考虑，假设未来三年公司营业收入增速均保持在 25.00%年均复合增长率、经营活动现金流量净额占营业收入比重为 6.00%，预计未来三年经营活动现金流量净额总计为 16,945.91 万元，具体如下：

单位：万元

项目	2026 年度	2027 年度	2028 年度
营业收入	74,080.46	92,600.58	115,750.72
经营性现金流量净额/营业收入	6.00%	6.00%	6.00%
经营性现金流量净额	4,444.83	5,556.03	6,945.04
未来期间经营活动现金流量净额	16,945.91		

综上，公司仅靠现有经营活动现金流，难以覆盖公司在原材料采购、生产备货及研发投入等未来日常运营周转等持续性的资金需求，考虑到未来公司进一步业务拓展及新生产项目建设情况，公司存在较大资金缺口。本次再融资部分募集资金用于补充流动资金，可有效优化公司资金结构、增强抗风险能力，并为主营业务的持续稳定发展提供保障。

4、各项资本性支出

未来三年，公司可预见的主要资本性支出金额约 76,320.00 万元，其中本次募集资金投资项目金额为 67,320.00 万元（不含补充流动资金），其他非募投项目资本性支出金额约 9,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	是否为募投项目	尚未投资金额
电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）	是	67,320.00
泰兴投资建设项目	否	5,000.00
东南亚制造中心建设项目	否	4,000.00
合计		76,320.00

注：上述尚未投资金额为预计数，最终以实际投资为准。

由上表可知，未来三年发行人存在较大金额的重大资本性支出，即使不考虑电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）拟使用的募集资金 47,400 万元，公司相关资本性支出的资金缺口仍达约 28,920.00 万元，补充流动资金具有必要性及合理性。

综上所述，综合考虑定期存款等货币资金余额、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等自身和外部条件，公司未来存在较高金额的营运资金需求。公司本次补充流动资金规模 4,000.00 万元，在发行人业务规模不断扩大的背景下，可以对发行人业务发展提供有力支持，改善发行人的现金流状况及资产负债结构、提高抗风险能力，具备必要性与合理性。

六、申报会计师核查情况

（一）核查程序

申报会计师执行了如下核查程序：

- 1、查阅发行人同行业可比项目公开资料，取得并查阅募投项目可行性研究报告，了解并复核本次募投项目内部收益率、投资回收期等指标的测算过程，

分析本次募投项目建设期、产销率和产能利用率、具体产品及对应单价等关键指标测算的依据和合理性；

- 2、访谈销售人员，了解公司下游市场情况；
- 3、分析本次募投项目新增折旧摊销合理性；
- 4、访谈发行人管理层，了解发行人报告期各期的业务发展情况，分析货币资金、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等变动趋势及本次补充流动资金规模的合理性。

（二）核查意见

针对上述问题，经核查，申报会计师认为：

（1）“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”内部收益率、投资回收期等指标测算具备审慎性与合理性，与同行业公司可比项目不存在重大差异。本次募投项目及后续二期项目新增折旧摊销对公司经营业绩影响较小，对公司未来经营业绩不构成重大不利影响，公司已在募集说明书中进行了风险提示。本次补充流动资金，系公司结合货币资金余额、资产负债结构、未来资金流入及流出、各项资本性支出等情况审慎确定，补充流动资金可以对发行人业务发展提供有力支持，改善发行人的现金流状况及资产负债结构、提高抗风险能力，具备必要性与合理性。

（2）经逐项核查，发行人本次募投项目的实施符合《证券期货法律适用意见第18号》第5条、《监管规则适用指引—发行类第7号》第5条的相关规定，具体情况如下：

序号	《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条	核查情况
1	通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。	经核查，申报会计师认为：发行人本次发行的募集资金总额为不超过人民币 51,400.00 万元（含本数），其中 47,400.00 万元属于资本性支出，4,000.00 万元属于非资本性支出，非资本性支出未超过募集资金总额的 30%。
2	金融类企业可以将募集资金全部用于补充资本金。	经核查，申报会计师认为：发行人不属于金融类企业，不适用本条规定。
3	募集资金用于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出的，视为补充流动资金。资本化阶段的研发支出不视为补充流动资金。工程施工类项目建设期超过一年的，视为资本性支出。	经核查，申报会计师认为：发行人本次募投项目电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）拟使用募集资金投入的部分用于资本性支出，符合相关要求。
4	募集资金用于收购资产的，如本次发行董事会前已完成资产过户登记，本次募集资金用途视为补充流动资金；如本次发行董事会前尚未完成资产过户登记，本次募集资金用途视为收购资产。	经核查，申报会计师认为：本次募集资金未用于收购资产，不适用本条规定。
5	上市公司应当披露本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成以及补充流动资金占募集资金的比例，并结合公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情况，论证说明本次补充流动资金的原因及规模的合理性。	经核查，申报会计师认为：发行人已于相关申请文件中披露本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成，已充分考虑公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情况等因素。

序号	《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条	核查情况
6	保荐机构及会计师应当就发行人募集资金投资构成是否属于资本性支出发表核查意见。对于补充流动资金或者偿还债务规模明显超过企业实际经营情况且缺乏合理理由的，保荐机构应当就本次募集资金的合理性审慎发表意见。	经核查，申报会计师认为：发行人本次发行的募集资金总额为不超过人民币 51,400.00 万元（含本数），其中 47,400.00 万元属于资本性支出，4,000.00 万元属于非资本性支出，非资本性支出未超过募集资金总额的 30%。本次募集资金能够满足公司业务发展的需要，有利于增强发行人核心竞争力，具有必要性和合理性。

序号	《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5 条	核查情况
1	对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可行性研究报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明。	经核查，申报会计师认为：发行人已结合可行性研究报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露了效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。本次募投项目可行性研究报告未超过一年。
2	发行人披露的效益指标为内部收益率或投资回收期的，应明确内部收益率或投资回收期的测算过程以及所使用的收益数据，并说明募投项目实施后对公司经营的预计影响。	经核查，申报会计师认为：发行人本次募投项目内部收益率及投资回收期的测算过程以及所使用的收益数据合理，发行人已披露本次发行对公司经营的预计影响。
3	上市公司应在预计效益测算的基础上，与现有业务的经营情况进行纵向对比，说明增长率、毛利率、预测净利率等收益指标的合理性，或与同行业可比公司的经营情况进行横向比较，说明增长率、毛利率等收益指标的合理性。	经核查，申报会计师认为：发行人已与现有业务的经营情况进行纵向对比并与可比公司的经营情况进行横向对比，本次募投项目相关收益指标具有合理性。

序号	《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5 条	核查情况
4	保荐机构应结合现有业务或同行业上市公司业务开展情况，对效益预测的计算方式、计算基础进行核查，并就效益预测的谨慎性、合理性发表意见。效益预测基础或经营环境发生变化的，保荐机构应督促公司在发行前更新披露本次募投项目的预计效益。	经核查，申报会计师认为：申报会计师已结合前述情况进行核查，本次募投项目效益预测具备谨慎性、合理性；截至本回复出具之日，本次募投项目效益预测基础或经营环境未发生变化。

问题 2、关于公司业务与经营情况

根据申报材料，1) 报告期内，公司营业收入分别为 36,003.93 万元、43,218.84 万元和 59,264.37 万元；扣非后归母净利润分别为 2,716.47 万元、2,439.14 万元和 4,700.36 万元。2) 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,211.89 万元、19,563.02 万元和 19,678.74 万元。3) 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 23,158.21 万元、31,459.60 万元和 39,141.83 万元。4) 报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 9,747.77 万元、33,912.82 万元和 30,345.81 万元，主要为定期存款。

请发行人说明：（1）结合下游晶圆、先进封装行业周期，需求及供给情况，同行业公司产能规模及建设情况，公司报告期内相关产品的销售价格、销量、成本费用等，说明公司营业收入、毛利率及净利润变动的原因，相关变动趋势与同行业可比公司是否一致；公司是否存在可转债兑付风险，风险揭示是否充分，应对措施是否有效，能否充分保护中小投资者利益；

（2）公司报告期内应收账款规模增长的原因，结合坏账准备计提政策、应收账款账龄、境内外客户期后回款情况、同行业可比公司计提情况等，说明公司应收坏账计提是否充分；

（3）公司报告期内固定资产规模增长较快的原因，与产能规模及业务收入的匹配情况，结合产能利用率、产品技术迭代速度，分析主要固定资产是否存在减值迹象，固定资产减值计提是否充分；

（4）公司持有大额定期存款的原因及合理性，利息收入与存款规模是否匹配，是否存在质押、冻结、隐形担保等受限或被占用情形；

（5）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况；结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求。

请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。请保荐机构及申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 1 条、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 1 条对问题（5）进行核查并发表明确意见。

回复:

一、结合下游晶圆、先进封装行业周期，需求及供给情况，同行业公司产能规模及建设情况，公司报告期内相关产品的销售价格、销量、成本费用等，说明公司营业收入、毛利率及净利润变动的原因，相关变动趋势与同行业可比公司是否一致；公司是否存在可转债兑付风险，风险揭示是否充分，应对措施是否有效，能否充分保护中小投资者利益

（一）结合下游晶圆、先进封装行业周期，需求及供给情况，同行业公司产能规模及建设情况，公司报告期内相关产品的销售价格、销量、成本费用等，说明公司营业收入、毛利率及净利润变动的原因

报告期内，公司营业收入、毛利率、净利润情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年		2024 年		2023 年
	金额	金额	变动	金额	变动	金额
营业收入	34,605.33	59,264.37	37.13%	43,218.84	20.04%	36,003.93
毛利率	28.40%	29.01%	2.59%	26.42%	-0.76%	27.18%
净利润	2,202.10	5,163.46	54.24%	3,347.75	2.51%	3,265.73

报告期内，公司营业收入、净利润持续增长，毛利率较为稳定，相关变动主要受下游晶圆和先进封装行业周期、需求及供给情况、同行业公司产能规模及建设情况以及公司报告期内相关产品的销售价格、销量、成本费用等因素影响，具体如下：

1、下游晶圆制造、先进封装行业周期，需求及供给情况

（1）在需求端，下游晶圆制造、先进封装行业快速发展带动半导体材料行业景气上行

近年来，在政策支持、产业链创新发展及下游晶圆厂扩产等因素多重驱动下，晶圆制造、先进封装市场规模均呈现高速发展趋势。根据中商产业研究院数据，2025 年全球晶圆制造市场规模为 1,698 亿美元，先进封装市场规模为 531 亿美元。受下游市场规模快速扩张影响，半导体材料市场规模亦呈稳步增长态势。根据 SEMI 数据，2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%，达到 732 亿美元。晶圆制造材料和封装材料两大板块实现双增长，一方

面源于芯片制造工艺复杂度不断提升、先进制程需求旺盛；另一方面也反映出市场对高性能计算、高带宽存储相关制造环节的投资在持续加码。其中，晶圆制造材料市场规模为 457.9 亿美元，同比增长 5.4%，光刻相关材料（包括光掩膜、光刻胶及辅助材料）以及湿化学品均实现强劲的双位数增长，得益于更高的工艺强度和更严苛的光刻要求持续推动材料消耗量增加。封装材料市场规模为 273.6 亿美元，同比增长 9.3%。预计 2026 年全球半导体材料市场将增长 12.2%，市场规模将达到 820.5 亿美元，其中晶圆制造材料市场规模约增长 9.8%，将达到 503 亿美元，封装材料市场规模约增长 16%，将达到 317.5 亿美元。

我国集成电路产业在汽车电子、消费电子、人工智能等应用场景牵引下，2026 年预计将保持快速增长态势，带动中国半导体材料市场规模增速高于全球增速，2025 年中国半导体材料市场规模增长至 156 亿美元，同比增长 12.5%。公司电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心产品属于光刻胶和湿电子化学品领域，是半导体材料的重要组成部分，随着晶圆制造及先进封装产业规模迅速扩张，以及相关制造工艺向精细化、复杂化方向发展，下游客户对相关电子化学品的需求不断增加，对材料纯度、性能及批次稳定性的要求亦持续提高，推动相关材料市场需求规模扩大，光刻胶和湿电子化学品相关领域已成为半导体材料市场增长的重要驱动力。

（2）在供给端，下游需求增长及国产替代背景下，发行人产品验证与供货持续推进

目前，全球半导体材料主要供应商集中于日本、韩国、美国及欧洲，国内部分高端材料仍依赖进口。在晶圆制造光刻胶领域，国内企业已在紫外宽谱、g 线、i 线等产品领域实现本土化供应，但在中高端产品领域的供应能力仍有待提升；在先进封装光刻胶领域，随着 HBM3E、Chiplet3D 堆叠、CoWoS-L 等先进封装技术突破带来的市场应用机遇，国产厂商在高端厚膜光刻胶、PSPI 等产品领域实现技术与产业化突破；在湿电子化学品领域，国内企业已形成一定供应能力，但部分高纯及功能性产品市场仍主要由国外厂商占据。随着国内晶圆制造、先进封装等领域客户对供应链稳定性及本土配套能力的重视程度提高，以及国产材料的验证与导入持续推进，具备相应技术和产品能力的国产厂商具有良好的业务拓展机遇与空间。

在上述背景下，报告期内，发行人围绕相关领域的客户需求，聚焦“电镀液+光刻胶”双核心赛道，在国产化率低、技术壁垒高的关键环节持续突破，成为高端电子化学品自主创新的核心力量之一。电镀液业务是公司的业绩基本盘，在先进封装领域，公司能够提供从电镀

液到配套试剂的整体解决方案，产品覆盖 HBM、3D 堆叠芯片等高端封装形式的核心工艺环节，可满足凸块制作、通孔填充、铜互连等复杂制程需求。凭借“电镀+光刻”双工艺协同优势，公司深度绑定国内先进封装龙头企业，成为先进封装领域电镀液的主力供应商之一，充分受益于高算力需求驱动的先进封装市场扩容。在晶圆制造领域，公司已跻身国内电镀液供应商第一梯队，尤其在先进制程领域处于国内前列，产品覆盖 28nm、14nm 及以下先进制程的全链条需求，主要服务于国内头部晶圆厂。光刻胶业务是公司的核心增长极，在先进封装光刻胶领域，公司已构建完整产品矩阵，是国内该领域的龙头企业；在晶圆制造光刻胶领域，公司是国产化的开拓者，正性 PSPI 实现国内首例量产，多款高端光刻胶产品填补国内技术空白，进一步提升了公司在晶圆制造光刻胶领域的话语权。

因此，在下游半导体材料需求持续增长及国产供应商验证导入持续推进的背景下，发行人电镀液、光刻胶等相关产品于报告期内持续实现客户导入及供货，收入规模持续扩大，与下游行业整体景气上行，国产供应链加速建设的行业趋势一致。

2、同行业公司产能规模及建设情况

在我国半导体材料行业整体上行趋势下，同行业公司目前均处于产能加速建设布局阶段。根据公开信息，同行业可比公司产能及产能利用情况如下：

序号	公司简称	产能规模及建设情况	产能利用情况
1	上海新阳	1、松江本部现有产能 1.9 万吨/年，新建项目规划设计产能 5 万吨/年，预计 2027 年建成 2、合肥新阳现有产能 1.7 万吨/年，规划扩充至 4.35 万吨/年，新增产能预计 2026 年底建成 3、上海化学工业区规划设计产能 3.05 万吨/年，预计 2026 年 9 月开工建设，2028 年 6 月竣工，2028 年年底投产	1、松江本部产能利用率处于较高水平，部分产线接近满产 2、合肥新阳现有产能利用率处于较高水平 3、上海化学工业区尚未投产
2	安集科技	1、上海金桥、宁波北仑制造基地目前已投产，多条新增产线建设中 2、上海化学工业区电子化学品专区制	2023 年度，安集科技化学机械抛光液类产品产能已达 29,092.26 吨，产能利用率为 70.81%；功能性湿电子化学品类产品产能已达

序号	公司简称	产能规模及建设情况	产能利用情况
		造基地目前已实现主体建筑封顶	3,411.88 吨，产能利用率为 75.85%
3	晶瑞电材	2025 年，晶瑞电材主要产品产能及建设情况如下： 1、高纯化学品设计产能 436,000 吨 2、工业化学品设计产能 193,000 吨，在建产能 20,000 吨 3、光刻胶设计产能 2,800 吨，在建产能 30,000 吨 4、锂电池材料设计产能 35,000 吨，在建产能 130,000 吨 5、能源类产品设计产能 361,740 吨	2025 年，晶瑞电材主要产品产能利用情况如下： 1、高纯化学品产能利用率为 64.75% 2、工业化学品产能利用率为 132.47% 3、光刻胶产能利用率为 50.88% 4、锂电池材料产能利用率为 62.04% 5、能源类产品产能利用率为 75.59%
4	天承科技	2025 年，天承科技主要产线产能及建设情况如下： 1、上海天承化学有限公司年产 30,000 吨专项电子材料电子化学品项目一期设计产能 30,000 吨 2、集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目 3、广东天承化学有限公司年产 30,000 吨专项电子材料电子化学品项目设计产能 30,000 吨，目前尚未投产，预计 2027 年 4 月完工	2025 年，天承科技主要产线产能利用情况如下： 1、上海天承化学有限公司年产 30,000 吨专项电子材料电子化学品项目一期产能利用率为 81.44% 2、集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目产能利用率为 9.60% 3、广东天承化学有限公司年产 30,000 吨专项电子材料电子化学品项目尚未投产

注：上海新阳现有产能及建设情况、产能利用情况来源于投资者关系活动记录表；安集科技现有产能及建设情况来源于投资者关系活动记录表，产能利用情况来源于《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》；晶瑞电材、天承科技现有产能及建设情况、产能利用情况均来源于 2025 年年度报告。

由上表可见，报告期内下游行业景气度持续上行，同行业可比公司均处于产能扩建阶段，产能规模与营业收入呈同步增长趋势。

3、公司报告期内相关产品的销售价格、销量、成本费用

报告期内，公司毛利率受产品结构变化、单价、单位成本变动影响略有波动，但总体保持稳定，主要产品销量增长带动营业收入快速增长。同时公司期间费用率基本稳定，净利润随收入规模扩大而同步增长，与收入变动趋势基本一致，具体分析如下：

(1) 公司主要型号产品平均单价、单位成本及毛利率情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率	收入
主营业务	28.35 %	34,109.1 6	28.85 %	57,394.7 7	26.56 %	41,904.2 5	27.39 %	34,486.3 6
其中： 电镀液 及配套 试剂	41.45%	15,513.88	38.79%	28,775.70	44.82%	19,608.44	40.05%	17,879.96
光刻胶 及配套 试剂	32.01%	8,512.61	35.51%	13,591.69	22.21%	9,468.74	28.27%	6,877.32
电镀 配套材 料	4.97%	10,011.34	3.49%	14,812.90	2.00%	12,665.31	1.65%	9,474.39

注：公司报告期内主营业务包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂、电镀配套材料与其他电子化学品，报告期内公司电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂以及电镀配套材料收入占主营业务收入比重超过 99%，其他电子化学品收入占比较低，对毛利率影响极小，故不再列示。

如上表所示，公司主营业务毛利率分别为 27.39%、26.56%、28.85%和 28.35%，整体保持稳定，不同产品的毛利率变动情况有所差异。报告期内，公司不同产品平均单价、单位成本及毛利率情况分析如下：

1) 电镀液及配套试剂毛利率变动原因

报告期内，公司电镀液及配套试剂的销售价格、销量、单位成本情况如下：

年度	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	销量 (吨)	单位售价 (元/公斤)	单位成本(元 /公斤)	毛利率
2026 年 1-6 月	15,513.88	9,083.38	3,700.99	41.92	24.54	41.45%
2025 年	28,775.70	17,614.63	7,305.17	39.39	24.11	38.79%
2024 年	19,608.44	10,820.09	5,839.93	33.58	18.53	44.82%
2023 年	17,879.96	10,719.26	5,063.56	35.31	21.17	40.05%

注：本题销量数据包含公司自产、外协和外购产品在内的全口径销量数据，下同。

报告期各期，公司电镀液及配套试剂毛利率分别为 40.05%、44.82%、38.79%和 41.45%，整体较稳定，各期变化主要与产品结构、销售单价及单位成本有关。2024 年电镀液及配套试剂产品毛利率有所上升，主要系先进封装相关产品及添加剂等较高毛利产品收入占比提升所致；2025 年电镀液及配套试剂产品毛利率有所下降，主要系 INOFINE 纳入合并范围及硫酸亚锡销售规模扩大所致。

2) 光刻胶及配套试剂毛利率变动原因

报告期内，公司光刻胶及配套试剂的销售价格、销量、单位成本情况如下：

年度	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	销量 (吨)	单位售价(元/ 公斤)	单位成本(元 /公斤)	毛利率
2026 年 1-6 月	8,512.61	5,788.10	4,171.07	20.41	13.88	32.01%
2025 年	13,591.69	8,764.64	7,805.17	17.41	11.23	35.51%
2024 年	9,468.74	7,366.19	5,100.14	18.57	14.44	22.21%
2023 年	6,877.32	4,932.83	3,069.38	22.41	16.07	28.27%

报告期各期，公司光刻胶及配套试剂毛利率分别为 28.27%、22.21%、35.51%和 32.01%，各期毛利率的变化主要受毛利率相对较高的自研光刻胶收入占比及单位成本影响。2025 年以来，随着先进封装负性光刻胶在多家客户完成产品替换并逐步放量，公司自研光刻胶收入占比上升，叠加南通工厂产能持续释放带来的规模效应以及 NMP、环戊酮等主要原材料价

格下降等因素，带动整体毛利率水平上升。

3) 电镀配套材料毛利率变动原因

报告期内，公司电镀配套材料的销售价格、销量、单位成本情况如下：

年度	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	销量(吨)	销售价格(元/ 公斤)	单位成本(元 /公斤)	毛利率
2026 年 1-6 月	10,011.34	9,513.42	283.95	352.58	335.04	4.97%
2025 年	14,812.90	14,295.40	587.46	252.15	243.34	3.49%
2024 年	12,665.31	12,411.42	550.78	229.95	225.34	2.00%
2023 年	9,474.39	9,317.71	472.08	200.69	197.38	1.65%

报告期内，公司电镀配套材料收入对应主要产品为锡球等，毛利率较低。受备货及生产周期影响，产品销售价格与原材料采购成本的变化存在一定时间差。报告期内，锡材价格上涨带动产品销售价格上升，同时由于前期备货成本相对较低，带动该类产品毛利率有所上升。

(2) 发行人持续提高研发投入，期间费用率略有增长

报告期内，公司的期间费用率和净利率情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	金额	变动	金额	变动	金额
营业收入	34,605.33	59,264.37	37.13%	43,218.84	20.04%	36,003.93
期间费用	8,234.39	13,088.67	49.40%	8,760.65	24.39%	7,042.79
其中：研发费用	4,549.37	6,942.21	51.24%	4,590.17	40.42%	3,268.79
期间费用率	23.80%	22.09%	1.81%	20.27%	0.71%	19.56%
净利润	2,202.10	5,163.46	54.24%	3,347.75	2.51%	3,265.73
净利率	6.36%	8.71%	0.97%	7.75%	-1.32%	9.07%

报告期内，公司期间费用率有所增长，主要受公司研发投入快速增长带动。公司近年来根据半导体行业下游技术升级及国产供应链建设需求，持续加大电镀液、光刻胶等相关领域的研发投入，研发成果逐步通过客户验证并实现产业化，推动高附加值产品收入增长，形成研发投入与业务发展的良性循环。

综上所述，报告期内下游晶圆制造、先进封装行业快速发展带动公司所处的半导体材料行业景气上行，同行业可比公司均处于产能扩建阶段，公司主要产品销量增长带动营业收入快速增长。同时，毛利率和期间费用率总体稳定，净利润随收入规模扩大同步增长，与收入变动趋势基本一致。

（二）相关变动趋势与同行业可比公司是否一致

报告期内，公司与同行业可比公司营业收入、毛利率、净利润的比较情况如下：

项目	公司	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
营业收入（万元）	上海新阳	119,857.86	193,668.49	147,518.33	121,242.04
	安集科技	152,635.96	250,421.79	183,501.52	123,787.11
	晶瑞电材	94,910.26	160,981.14	143,511.12	129,941.51
	天承科技	30,638.24	47,096.49	38,067.10	33,892.89
	发行人	34,605.33	59,264.37	43,218.84	36,003.93
毛利率	上海新阳	42.29%	41.00%	39.29%	35.16%
	安集科技	55.63%	56.72%	58.45%	55.81%
	晶瑞电材	23.57%	24.94%	19.23%	23.61%
	天承科技	36.98%	40.04%	39.85%	35.70%
	发行人	28.40%	29.01%	26.42%	27.18%
净利润（万元）	上海新阳	21,337.29	30,097.15	17,539.06	16,763.89
	安集科技	53,171.72	78,364.83	53,364.36	40,273.38
	晶瑞电材	5,804.27	19,620.57	-19,139.55	1,013.43
	天承科技	6,119.16	8,642.37	7,467.99	5,857.23
	发行人	2,202.10	5,163.46	3,347.75	3,265.73

如上表所示，报告期内公司和同行业可比公司的营业收入与净利润均呈现持续增长趋势，整体变动趋势保持一致，公司和可比公司毛利率整体呈现较为稳定态势，变动趋势不存在较大差异。

（三）公司是否存在可转债兑付风险，风险揭示是否充分，应对措施是否有效，能否充分保护中小投资者利益

1、公司是否存在可转债兑付风险

（1）公司近年来盈利状况良好，偿债能力能够得到有效保障

2023年、2024年和2025年，公司归属于母公司股东的净利润分别为3,265.73万元、3,347.75万元和5,123.78万元，平均可分配利润为3,912.42万元。

公司参考2025年6月30日至2026年6月30日期间公开发行的、期限6年、票面利率实行累进利率、评级结果为AA级和AA_{Sti}级的可转换公司债券利率条款设置情况，假设本次可转换公司债券于2026年完成发行，发行规模为上限51,400.00万元，按存续期内可转换公司债券持有人均未转股的情况测算，根据本次发行方案存续期内利息支付的测算结果如下：

单位：万元

时间	平均利率	平均利息
第一年	0.13%	66.82
第二年	0.33%	169.62
第三年	0.63%	323.82
第四年	1.04%	534.56
第五年	1.54%	791.56
第六年	2.00%	1,028.00

由上表可知，可转换公司债券存续期内按市场情况估计的平均利率支付的总利息金额为2,914.38万元，因此，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润可完全覆盖本次可转换公司债券存续期6年内的应付利息。

（2）公司各项经营指标较为稳健，整体偿债能力较强

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2026-6-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
流动比率	2.56	1.86	2.18	3.97
速动比率	2.22	1.64	1.94	3.79
资产负债率(合并)	24.28%	25.62%	21.38%	20.60%
资产负债率(母公司)	24.78%	22.62%	21.90%	18.46%
项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
利息保障倍数(倍)	13.39	12.37	16.13	15.47

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 20.60%、21.38%、25.62%和 24.28%，资产负债结构较为合理。报告期各期，利息保障倍数分别为 15.47、16.13、12.37 和 13.39，处于较高水平。

截至 2026 年 8 月 31 日，除 2026 年 6 月末应收账款期后回款比例因距离回款统计截止日较近，部分应收账款尚处于信用期内，导致期后回款比例为 49.66%外，其余各期应收账款期后回款比例均超过 95%，公司整体回款情况良好。报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 21,282.39 万元、29,563.73 万元、51,092.59 万元和 26,220.62 万元，现金流较为充足。截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 18,371.50 万元，可支配资金 10,154.18 万元，银行授信额度 12.05 亿元，其中未使用额度为 10.05 亿元。

因此，发行人报告期内资产负债结构较为合理、应收账款期后回款情况良好，融资渠道畅通，现金流与授信额度充足，具备偿付本次可转债本息的能力。

(3) 本次可转债进入转股期后，随着投资者逐渐转股，本息兑付风险进一步下降

可转债具有股票期权的特性，公司已设置转股价格向下修正条款等促转股安排，随着公司业务的持续发展，预计存续期内可转债将逐渐转股，债券余额相应转为公司股本，公司到期的本金偿付义务逐步缩减，还本付息压力进一步下降。此外，即使极端情形下部分可转债未能转股，公司亦可凭借经营性现金流、货币资金及银行授信等渠道按期偿付，不存在重大

偿债风险。

综上，公司盈利及现金流状况良好、资金储备和融资渠道充足，且可转债预计将陆续转股，可转债兑付风险较小。

2、风险揭示是否充分，应对措施是否有效，能否充分保护中小投资者利益

发行人已在募集说明书之“第三节 风险因素”之“三、其他风险”之“（二）与本次可转债相关的风险”中对可转债相关风险进行了补充修改，具体如下：

“在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。若国家政策、法规、下游行业周期、市场需求及供给、行业竞争格局等因素发生重大不利变化，公司经营活动将可能无法实现预期的回报，使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。”

为进一步应对兑付风险，充分保护中小投资者利益，公司将采取以下具体措施：

1、技术方面，公司将持续加强研发投入，在光刻胶领域，重点推进相关产品的技术迭代与稳定量产，加大光刻胶树脂自研自产力度；电镀液领域，推动 28nm、14nm 及以下晶圆制造电镀产品的稳定量产；优化添加剂配方，进一步提升产品稳定性与性能表现。与国内知名高校、科研机构建立长期深度合作，引进行业顶尖技术人才，持续扩充研发团队规模，筑牢技术创新根基，持续提升核心竞争力；

2、产品方面，公司将持续深化与国内头部厂商的合作，开发具有市场竞争力的产品。晶圆制造领域，公司将重点突破实现 28nm 制程电镀液批量供货，并逐步向 14nm 及以下制程渗透。存储芯片领域，适配 HBM、3DNAND 等先进存储技术需求，目标成为国内存储芯片材料核心供应商；半导体显示领域，加快 OLED 光刻胶客户验证进度，实现向头部企业批量供货，并拓展至海外面板企业；

3、财务方面，公司将科学合理地规划各类投融资活动，保持畅通的融资渠道，与银行建立长期良好的合作关系；根据行业及市场、公司战略规划、资本市场情况、宏观经济情况等因素，维持合理的资本结构，使公司有息负债规模及资产负债率处于合理的水平，降低财务风险。

二、公司报告期内应收账款规模增长的原因，结合坏账准备计提政策、应收账款账龄、境内外客户期后回款情况、同行业可比公司计提情况等，说明公司应收坏账计提是否充分

（一）报告期内应收账款规模增长的原因

报告期各期末，公司应收账款账面余额、坏账准备及账面价值情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026-6-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收账款账面余额	25,067.79	20,810.98	20,667.81	16,090.94
坏账准备	1,318.63	1,132.24	1,104.79	879.05
综合计提比例	5.26%	5.44%	5.35%	5.46%
应收账款账面价值	23,749.16	19,678.74	19,563.02	15,211.89
营业收入	34,605.33	59,264.37	43,218.84	36,003.93
应收账款账面价值/当期营业收入	34.31%	33.21%	45.27%	42.25%

注：为增强可比性，2026 年 6 月末应收账款账面价值/2026 年 1-6 月营业收入已年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,211.89 万元、19,563.02 万元、19,678.74 万元和 23,749.16 万元，占同期营业收入的比例分别为 42.25%、45.27%、33.21%和 34.31%，整体呈下降趋势。公司各期末应收账款主要客户为半导体行业头部企业，与公司长期合作且经营状况良好，应收账款质量较好。

报告期内，随着公司销售收入规模的扩大，公司应收账款规模总体同步提高。2025 年末，公司应收账款账面余额基本保持稳定，应收账款账面价值占当期营业收入的比例有所下降，主要系 2025 年上半年行业景气度较高，公司当年上半年收入占比相较 2024 年和 2023 年有所提升，年末尚处于信用期内的应收账款规模占全年营业收入比例降低，同时随着公司加强应收账款催收回款力度，应收账款周转率提升所致。

综上所述，公司报告期内应收账款余额随营业收入的增长而增长，增长趋势与营业收入相匹配，具有合理性。

（二）结合坏账准备计提政策、应收账款账龄、境内外客户期后回款情况、同行业可比公司计提情况等，说明公司应收坏账计提是否充分

报告期内，公司综合考虑客户资信状况、账龄结构、历史回款情况、期后回款进展及预计可收回金额等因素对应收账款计提坏账准备，应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异，计提政策符合业务实际和客户信用风险特征，坏账准备计提充分，不存在坏账准备计提不足的情形。具体分析如下：

1、坏账准备计提政策

公司根据《企业会计准则》的相关规定，以预期信用损失为基础，对应收账款及合同资产进行减值测试并确认损失准备。对于存在客观证据表明已发生信用减值的应收账款（如债务人发生严重财务困难、进入破产重整程序、涉及重大诉讼等），公司按单项计提预期信用损失；除单项计提外的应收账款，公司以账龄作为信用风险特征划分组合，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测（前瞻性调整），确定各账龄区间的预期信用损失率，具体计提比例如下：

账龄	预期信用损失率（计提比例）
1年以内（含，下同）	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

注：对单项计提坏账准备的应收账款，公司根据其预计可收回金额与账面余额的差额全额或部分计提。

2、应收账款账龄情况

报告期各期末，公司应收账款账龄分布情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026-6-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,759.49	98.77%	20,463.91	98.33%	20,183.81	97.66%	15,640.70	97.20%
1至2年	201.83	0.81%	221.24	1.06%	393.08	1.90%	332.27	2.06%

项目	2026-6-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
2至3年	58.80	0.23%	72.37	0.35%	28.45	0.14%	25.90	0.16%
3至4年	9.17	0.04%	3.78	0.02%	20.41	0.10%	70.37	0.44%
4至5年	17.23	0.07%	18.90	0.09%	22.56	0.11%	4.35	0.03%
5年以上	21.27	0.08%	30.77	0.15%	19.50	0.09%	17.36	0.11%
合计	25,067.79	100.00%	20,810.98	100.00%	20,667.81	100.00%	16,090.94	100.00%

报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款余额占比分别为97.20%、97.66%、98.33%和98.77%，账龄在1年以上应收账款余额均不超过3%，应收账款质量良好。

3、境内外客户期后回款情况

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026-6-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
应收账款余额	25,067.79	20,810.98	20,667.81	16,090.94
其中：境内应收账款余额	23,566.95	19,420.50	18,742.47	15,254.46
境外应收账款余额	1,500.84	1,390.47	1,925.34	836.48
期后回款金额	12,448.06	20,090.37	20,527.87	16,042.13
其中：境内应收账款期后回款金额	11,393.95	18,721.28	18,602.53	15,205.65
境外应收账款期后回款金额	1,054.10	1,369.09	1,925.34	836.48
期后回款比例	49.66%	96.54%	99.32%	99.70%
其中：境内应收账款期后回款比例	48.35%	96.40%	99.25%	99.68%
境外应收账款期后回款比例	70.23%	98.46%	100.00%	100.00%

注：期后回款统计截至2026年8月31日。

公司境内客户主要为国内大中型企业，结算流程规范，回款能力稳定。公司境外客户主要为长期合作客户，具备良好的偿付能力。截至2026年8月31日，公司2023年末、2024年末、2025年末及2026年6月末应收账款期后回款比例分别为99.70%、99.32%、96.54%及49.66%，境内外客户总体回款情况均较好。2026年6月末应收账款期后回款比例较低，主要系距离回款统计截止日较近，部分应收账款尚处于信用期内所致。公司境内外客户期后回款

情况良好，相关款项回收不存在重大不确定性。

4、与同行业可比公司坏账准备计提政策对比

公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况如下：

账龄	上海新阳	安集科技	晶瑞电材	天承科技	发行人
6 个月以内	5.00%	未披露	1.00%	5.00%	5.00%
6 个月-1 年	5.00%		5.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%		10.00%	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%		20.00%	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%		50.00%	未披露	50.00%
4-5 年	80.00%		100.00%		80.00%
5 年以上	100.00%		100.00%		100.00%

注：同行业可比公司数据来自于相关公司 2025 年年度报告，其中安集科技按预期信用减值损失计量坏账准备金额，未披露分账龄具体坏账准备比例；天承科技无 3 年以上按账龄组合计提的应收账款。

由上表可见，公司账龄组合计提比例与上海新阳一致，整体处于同行业可比公司区间之内，不存在显著低于同行业的情形。

公司与同行业可比公司应收账款坏账准备综合计提比例对比情况如下：

公司名称	2026-6-30	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
上海新阳	7.18%	6.90%	10.09%	9.91%
安集科技	5.22%	5.07%	5.01%	5.00%
晶瑞电材	2.11%	2.07%	3.52%	7.72%
天承科技	5.46%	5.52%	5.65%	5.68%
平均值	4.99%	4.89%	6.07%	7.08%
发行人	5.26%	5.44%	5.35%	5.46%

注：1、综合计提比例=坏账准备余额/应收账款余额；2、数据来源于同行业公司披露的定期报告。

由上表可见，公司坏账准备综合计提比例较为稳定，与公司的账龄结构相匹配，整体处于同行业可比公司区间范围内，不存在重大差异。

综上所述，公司应收账款规模增加主要系公司营业收入持续增加所致，坏账准备计提政策符合企业会计准则规定，应收账款账龄较短且稳定，境内外客户期后回款情况良好，与同行业可比公司计提情况不存在重大差异，公司应收坏账计提充分。

三、公司报告期内固定资产规模增长较快的原因，与产能规模及业务收入的匹配情况，结合产能利用率、产品技术迭代速度，分析主要固定资产是否存在减值迹象，固定资产减值计提是否充分

（一）报告期内固定资产规模增长较快的原因，与产能规模及业务收入的匹配情况

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026-6-30		2025-12-31		2024-12-31		2023-12-31
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
房屋及建筑物	23,365.54	11.74%	20,910.14	3.54%	20,195.19	45.70%	13,860.79
机器设备	29,048.58	7.69%	26,975.36	59.17%	16,947.85	28.18%	13,222.00
运输工具	355.43	-0.62%	357.65	0.06%	357.42	27.97%	279.28
通用设备	730.86	2.79%	711.03	11.10%	639.97	160.14%	246.01
合计	53,500.41	9.29%	48,954.18	28.35%	38,140.43	38.15%	27,608.08

报告期内，公司固定资产规模增长较快，主要由以下因素驱动：一是公司前次募集资金投资项目“集成电路材料测试中心项目”建筑物达到预定可使用状态转固，以及投入资金购置研发、测试设备等；二是为满足光刻胶及配套树脂等新产品的生产需求，公司对相关产线进行改造，并同步更新质检设备、三废处理设施等配套设施；三是为深化海外渠道建设、扩大国际客户覆盖，公司推进东南亚制造中心项目建设，增加相关厂房及生产设备投入。

报告期内，公司固定资产增加主要来源于为研发、测试等非直接用于生产的固定资产，相关投入主要用于技术研发及产品验证，对产能及营业收入的贡献具有间接性和滞后性。因此，以下选取直接用于产品生产的生产性固定资产作为分析口径，剔除研发、测试等非生产性固定资产的影响，分析生产性固定资产规模及其变动与产能、营业收入的匹配情况，具体如下：

单位：吨、万元

项目	2026 年 6 月末 /2026 年 1-6 月	2025 年末 /2025 年度	2024 年末 /2024 年度	2023 年末 /2023 年度
生产性固定资产原值 平均值	23,999.92	20,437.06	18,047.60	17,109.59
产能	13,000	13,000	13,000	12,500
产能/生产性固定资 产原值平均值	0.54	0.64	0.72	0.73
主营业务收入	34,109.16	57,394.77	41,904.25	34,486.36
主营业务收入/生产 性固定资产原值平均 值	2.84	2.81	2.32	2.02

注 1：生产性固定资产是指折旧摊销计入生产成本的固定资产，生产性固定资产原值平均值 =（期初生产性固定资产原值+期末生产性固定资产原值）/2；

注 2：为增强可比性，2026 年 1-6 月的主营业务收入/生产性固定资产原值平均值已年化处理。

1、固定资产规模与产能规模的匹配性分析

报告期内，公司产能与生产性固定资产原值平均值的比值分别为 0.73、0.72、0.64 和 0.54，生产性固定资产原值平均值增长快于产能增长。2024 年末及 2025 年末，公司新增生产性固定资产主要用于光刻胶及配套树脂等新产品的工艺设备改造，以及质检设备、三废处理设施等配套设施更新，上述投入主要用于提升产线运行效率、产品品质及配套保障能力，未直接形成相应的新增产能；2026 年 6 月末，生产性固定资产原值平均值增加主要系东南亚制造中心厂房达到预定可使用状态转固，但整体生产线尚未建设完毕，尚未形成新增产能。因此，报告期内产能与生产性固定资产原值平均值的比值略有下降，与公司生产性固定资产投入的用途相符。

2、固定资产规模与业务收入的匹配性分析

报告期内，公司主营业务收入与生产性固定资产原值平均值的比值分别为 2.02、2.32、2.81 和 2.84，主营业务收入增长快于生产性固定资产原值平均值的的增长。主要原因系随着公司业务持续拓展，订单需求增加，公司产能利用率由 2023 年度 50.34%逐步提升至 2026 年上半年的 91.92%，生产性固定资产的利用效率相应提高，带动主营业务收入增长。因此，上

述比值的变动与公司产能利用率提升的趋势一致，具有合理性。

综上所述，报告期内固定资产规模增长较快主要系公司研发、生产相关投入所致，固定资产规模与产能规模、业务收入的变动关系符合公司实际经营及资产投入情况，具有合理性。

（二）结合产能利用率、产品技术迭代速度，分析主要固定资产是否存在减值迹象，固定资产减值计提是否充分

报告期内，公司产能利用率持续提升，不存在因产能闲置、产品技术迭代或设备淘汰等因素导致的减值迹象。公司已按照企业会计准则的相关规定评估固定资产减值情况，固定资产减值准备计提充分，具体分析如下：

1、产能利用率情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量及产能利用率、产销率情况如下表所示：

项目	产品类别	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能（吨）		13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,500.00
产量 （吨）	电镀液及配套试剂	2,655.75	4,753.84	3,840.26	3,458.18
	光刻胶及配套试剂	4,316.55	6,801.27	5,229.60	3,419.53
	其他电子化学品	-	-	9.07	14.43
	合计	6,972.30	11,555.11	9,078.93	6,892.14
销量 （吨）	电镀液及配套试剂	2,476.82	4,629.03	3,737.89	3,383.89
	光刻胶及配套试剂	4,090.78	7,734.86	5,070.66	3,055.53
	其他电子化学品	-	-	9.68	13.62
	合计	6,567.60	12,363.89	8,818.23	6,453.04
产能利用率		91.92%	80.86%	63.61%	50.34%
产销率		94.20%	107.00%	97.13%	93.63%

注：上表中产量及销量不包括外购产品；为保持数据口径统一，在计算产能利用率剔除外协产品产量；半年度产能利用率=半年度折算全年产量/全年产能。

如上表所示，报告期内，随着公司业务的持续拓展，产能利用率分别为 50.34%、63.61%、80.86%和 91.92%，2023 年度，公司产能利用率相对较低，主要系南通工厂投产后新增产能尚处于爬坡阶段。随着下游需求增长及公司产品逐步放量，光刻胶及配套试剂、电镀液及配套试剂的产量和销量持续增加。在产能规模总体稳定的情况下，公司整体产能利用率持续提

升，南通工厂新增产能有效消化，不存在产能长期闲置的情形。

2、产品技术迭代情况

从产品端来看，公司主要产品包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂，产品下游应用领域包括传统封装、先进封装、晶圆制造和新型显示等领域，公司产品的技术升级主要围绕产品性能提升及下游工艺要求展开。一方面，公司通过优化产品配方及加料、混合、过滤等生产工艺，提升产品性能、质量及稳定性；另一方面，公司在传统封装产品的基础上，逐步从电镀液产品向外延伸，并围绕先进封装、晶圆制造和新型显示等领域的光刻工艺需求开发光刻胶及配套试剂。上述技术演进体现为产品性能提升及应用领域拓展，不同产品对应不同工艺需求，新产品与既有产品均具有较为广阔的市场空间。同时，半导体材料需经过下游客户严格的工艺适配、可靠性测试及量产认证，客户对已认证材料的更换较为谨慎。因此，公司主要产品在不同应用领域具有各自的需求基础，已认证产品具有一定的使用延续性，技术升级不会直接导致既有产品及对应生产设备同步淘汰。

从工艺端来看，公司主要产品的生产流程具有共性，产品升级以配方及工艺优化为实现方式，相关设备可在技术适用范围内持续使用。公司电镀液及配套试剂、光刻胶配套试剂主要采用复配、混合、过滤等生产工艺。不同产品的配方和原料存在差异，但关键生产流程基本相同。公司通过优化产品配方以及加料、混合、过滤等环节的操作方式和工艺参数，提升产品性能及质量。上述工艺特点决定了部分产品的技术升级能够通过配方调整及工艺优化实现。对于既有生产设备性能范围内的产品改进，原有设备仍可承担相应生产任务，产品的技术迭代不会导致生产设备的整体更换。

因此，公司现有产品具有充分的市场需求，未来产品技术升级主要通过配方及工艺优化实现性能提升，并将持续拓展应用领域，因产品技术迭代导致固定资产整体淘汰报废的风险较小。

3、分析主要固定资产是否存在减值迹象，固定资产减值计提是否充分

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额并进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者之间的较高者。固定资产减值准备一经计提，以后期间不得转回。上述会计政策符合《企业会计准则第8号——资产减值》的规定。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条规定的减值迹象，公司结合固定资产实际运行情况进行逐条对照评估，不存在减值迹象，具体分析如下：

序号	准则规定减值迹象	公司资产情况	是否存在该迹象
1	资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌	报告期内公司各项固定资产均在正常使用中，不存在资产市价大幅下跌的情形	否
2	企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响	半导体行业为国家产业政策重点支持领域，公司主营业务下游需求整体向好，经营环境未发生重大不利变化	否
3	市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低	报告期内，市场利率未发生对企业不利的重大变动，折现率未发生导致可收回金额大幅降低的变化	否
4	有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏	公司固定资产管理制度健全，定期盘点未发现主要设备存在残次冷背情况，主要设备工艺性能满足产品生产需求，不存在陈旧过时情形	否
5	资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置	报告期末主要固定资产均处于正常生产使用状态，不存在已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情形	否
6	企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或	报告期内，公司产能利用率持续提升，产销率保持 90%以上、营业收入持续增长、销售回款情况良好，与资产经济绩效预期不存在背离，资产经济绩效符合产能建设规划预期，未显著低于预期	否

序号	准则规定减值迹象	公司资产情况	是否存在该迹象
	者高于）预计金额等		
7	其他表明资产可能已经发生减值的迹象	公司不存在其他表明资产可能已经发生减值的迹象	否

综上所述，报告期内公司固定资产规模变化与公司业务发展及经营布局一致；报告期内，公司产能利用率情况良好，因产品技术迭代导致固定资产整体淘汰报废的风险较小，固定资产不存在减值迹象，未进行减值计提具有合理性。

四、公司持有大额定期存款的原因及合理性，利息收入与存款规模是否匹配，是否存在质押、冻结、隐形担保等受限或被占用情形

(一) 公司持有大额定期存款的原因及合理性

报告期各期末，公司定期存款本金规模如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
期初本金	37,000.00	35,000.00	14,000.00	11,300.00
本期新增购买本金	-	6,000.00	32,000.00	9,000.00
本期到期本金	9,000.00	4,000.00	11,000.00	6,300.00
期末本金	28,000.00	37,000.00	35,000.00	14,000.00
其中：1 年内到期	21,000.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00
1 年以上到期	7,000.00	28,000.00	31,000.00	9,000.00

由上表可见，报告期内公司持有一定规模的定期存款，主要系公司于 2023 年末收到首次公开发行股票募集资金，并于 2024 年将募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司根据项目资金分阶段投入的整体规划，在保障营运及项目建设资金需求的前提下，将部分闲置资金配置为定期存款等产品，提高资金使用效率。随着公司经营规模扩大并带动流动资金需求增加，公司定期存款规模相应下降。2026 年 6 月末，公司定期存款本金为 28,000.00 万元，较 2025 年末减少 9,000.00 万元，且 2026 年 1-6 月期间内未新增购买定期存款，与经营规模扩张背景下流动资金需求增加的情况相匹配。

(二) 利息收入与存款规模的匹配性

报告期各期，公司利息收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
定期存款利息	399.63	946.30	827.83	459.68

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
活期存款及通知存款利息	8.12	73.18	240.20	55.20
利息收入合计	407.75	1,019.48	1,068.03	514.88
定期存款利息占比	98.01%	92.82%	77.51%	89.28%

报告期内，公司定期存款利息收入与定期存款规模匹配情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
定期存款平均余额	32,500.00	36,000.00	24,500.00	12,650.00
定期存款利息	399.63	946.30	827.83	459.68
平均收益率	2.46%	2.63%	3.38%	3.63%

注 1：定期存款平均余额=（期初定期存款余额+期末定期存款余额）/2；

注 2：为增强可比性，2026 年 1-6 月定期存款平均收益率已年化处理。

报告期各期末，中国人民银行公布的存款基准利率及六大行挂牌利率情况如下表所示：

项目	6 个月定期存款	1 年定期存款	2 年定期存款	3 年定期存款
存款基准利率	1.30%	1.50%	2.10%	2.75%
2026 年 6 月末六大行存款基准利率	0.85%	0.95%	1.05%	1.25%
2025 年末六大行存款基准利率	0.85%	0.95%	1.05%	1.25%
2024 年末六大行存款基准利率	1.00%	1.10%	1.20%	1.50%
2023 年末六大行存款基准利率	1.35%	1.45%	1.65%	1.95%

注 1：央行自 2015 年 10 月 24 日更新“金融机构人民币存款基准利率调整表”之后，人民银行不再更新存款基准利率调整表，央行已逐步放开存款利率的上限管制，各银行实际执行的存款利率可以在此基础上进行调整；

注 2：以上为六大行挂牌利率，实际执行利率因地区、存款金额等因素可能存在差异。

报告期内，公司定期存款平均收益率分别为 3.63%、3.38%、2.63%和 2.46%。公司定期存款主要为大额存单，按照购买时约定的利率计提利息，2023 年度及 2024 年度平均收益率

相对较高，主要系部分大额存单于 2020 年至 2022 年利率较高时购入。公司定期存款平均收益率总体呈下降趋势，与同期存款基准利率的变动趋势一致。

因此，报告期内公司利息收入变动主要受定期存款持有规模及利率水平变化影响，利息收入与存款规模具有匹配性。

（三）是否存在质押、冻结、隐形担保等受限或被占用情形

报告期内，公司定期存款不存在质押、冻结、隐形担保或其他权利受限情形，亦不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

综上所述，公司持有定期存款的原因系在保障安全性与流动性的前提下提高资金使用效率，具有合理性，随着流动资金需求的增加，报告期末定期存款规模已有所下降。报告期内，公司利息收入与存款规模相匹配，定期存款不存在质押、冻结、隐形担保等受限或被占用情形。

五、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况；结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求

（一）财务性投资的认定标准

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条等相关规定，“财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》第一条的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

（二）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。自本次发行董事会决议日前六个月起至本问询函回复出具日，公司不存在新投入的和拟投入财务性投资的情况，具体说明如下：

1、投资类金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至本问询函回复出具日，公司不存在实施或拟实施的融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融投资。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月至本问询函回复出具日，公司不存在实施或拟实施投资金融业务的情形。

3、与公司主营业务无关的股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 26.02 万元，主要系公司投资苏州钧华 5%股权。发行人专注半导体电镀液、光刻胶等湿电子化学品，是国内电子化学品材料领域核心供应商之一；苏州钧华主营业务为高端电镀设备研发制造，主要产品覆盖晶圆水平电镀、镍钯金电镀及 TSV 高深宽比电镀设备。报告期内，发行人曾向苏州钧华采购过电镀、清洗、显影等半导体领域设备，用于产品研发及与主营产品的配套销售，该笔投资属于与公司主营业务有关的股权投资，不属于财务性投资。

除投资苏州钧华外，本次发行相关董事会决议日前六个月至本问询函回复出具日，公司不存在实施其他股权投资的情形。因此，公司不存在实施或拟实施与公司主营业务无关的股权投资的情形。

4、投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本问询函回复出具日，公司不存在已投资或拟投资产业基金、并购基金的情形。

5、拆借资金、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本问询函回复出具日，公司不存在已实施或拟实施对外拆借资金、委托贷款的情形。

6、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本问询函回复出具日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

综上，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本问询函回复出具日，公司不存在实施或拟实施财务性投资的情况。

（三）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资相关的财务报表科目分析如下：

单位：万元

项目	金额	是否涉及财务性投资	其中财务性投资金额
货币资金	18,371.50	否	-
其他应收款	161.83	否	-
一年内到期的非流动资产	22,160.40	否	-
其他流动资产	451.53	否	-
其他非流动资产	9,293.20	否	-
其他非流动金融资产	26.02	否	-

1、货币资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金账面余额为 18,371.50 万元，主要由银行存款和其他货币资金组成，其中其他货币资金主要为保函保证金等，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的财务性投资。

2、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 161.83 万元，主要系押金、保证金等，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的财务性投资。

3、一年内到期的非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 22,160.40 万元，均为

一年内到期的定期存款及利息。公司持有定期存款主要目的是为了提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，定期存款属于安全性高的现金管理产品。综上，定期存款不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的财务性投资。

4、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产金额为 451.53 万元，均为多缴税金或留抵税额，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的财务性投资。

5、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 9,293.20 万元，由定期存款、预付长期资产类款项构成，其中定期存款属于安全性高的现金管理类产品，预付长期资产类款项系发行人开展主营业务支付的款项，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的财务性投资。

6、其他非流动金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 26.02 万元，为公司持有的苏州钧华 5%股权，具体情况详见本回复本题之“（二）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况”之“3、与公司主营业务无关的股权投资”。该项投资系与公司主营业务有关的股权投资，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的财务性投资。

综上，截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在财务性投资，满足《证券期货法律适用意见第 18 号》等规定关于“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的相关要求。

六、申报会计师核查情况

（一）核查程序

申报会计师针对上述事项执行了以下核查程序：

1、查阅晶圆制造、先进封装行业研究报告，了解行业发展趋势及供需情况；

访谈发行人主要管理人员、查阅发行人及同行业可比公司定期报告，了解发行人收入、净利润、毛利率波动的原因及合理性，发行人业绩变动趋势与同行业可比公司的比较情况；

2、与发行人管理层及财务负责人沟通，了解报告期内应收账款规模增长的原因及信用政策；获取并复核了报告期各期末应收账款明细表及账龄分析表，分析应收账款增长与营业收入增长的匹配性；复核了坏账准备计提政策及预期信用损失模型的合理性，并与同行业可比公司坏账准备计提政策及综合计提比例进行对比；统计并复核了境内外客户期后回款情况，对大额应收账款抽查了销售合同、订单、出库单、发票及银行回款凭证，并实施了应收账款函证程序，核查回款的真实性及可回收性；

3、与发行人管理层沟通，了解报告期内固定资产快速增长的原因及经营布局；获取并复核了固定资产明细表、在建工程转固资料及产能、产量、销量明细，分析固定资产投入与产能规模、业务收入的匹配性；与生产及研发负责人沟通，了解主要设备的技术通用性、可升级性及产品技术迭代情况；对照《企业会计准则第8号——资产减值》第五条规定的减值迹象，逐项复核了发行人减值迹象评估的充分性及减值计提的准确性；

4、与发行人管理层及财务负责人进行沟通，了解公司持有大额定期存款的原因及资金管理策略；获取并复核了定期存款明细表、银行对账单及存单凭证，核查定期存款的存放机构、期限、利率及规模变动情况；复核了报告期各期利息收入测算过程，分析利息收入与定期存款规模及利率水平的匹配性；获取发行人银行账户开户清单、企业信用报告，对报告期内发行人货币资金实施银行函证程序，核查定期存款是否存在质押、冻结、担保或其他权利受限情形，以及是否被控股股东、实际控制人及其关联方占用；

5、查阅《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关规定，了解财务性投资认定标准；查阅发行人公告文件，包括最近一期的董事会和股东会会议文件、定期报告及相关临时公告等，核查本次董事会决议日前六个月至本问询回复出具日是否存在实施或拟实施的财务性投资业务；查阅发行人报告期内财务报告及相关科目明

细资料，了解发行人可能涉及财务性投资相关的财务报表科目情况，核查分析是否存在财务性投资情形；查阅苏州钧华公开信息，了解其主营业务情况。获取发行人与苏州钧华发生的合同、交易明细、交易凭证等资料，核查其与发行人之间的业务往来情况，访谈公司管理层及相关业务人员，了解双方未来合作安排等情况，判断其与公司主营业务相关性。

（二）核查意见

经核查，申报会计师认为：

1、报告期内，下游晶圆制造、先进封装行业快速发展带动公司所处的半导体材料行业景气上行，同行业可比公司均处于产能扩建阶段，公司主要产品销量增长带动营业收入增长，同时毛利率相对稳定，期间费用率略有上升，净利润随收入规模扩大同步增长，与收入变动趋势基本一致，相关变动趋势与同行业可比公司不存在较大差异；公司盈利及现金流状况较好、资金储备和融资渠道充足，且可转债预计将陆续转股，可转债兑付风险较小，公司已补充披露相关风险提示，并将采取相关应对措施，充分保护中小投资者利益；

2、公司应收账款规模增加主要系公司营业收入持续增加所致，坏账准备计提政策符合企业会计准则规定，应收账款账龄较短且稳定，境内外客户期后回款情况良好，与同行业可比公司计提情况不存在重大差异，公司应收坏账计提充分；

3、报告期内公司固定资产规模变化与公司业务发展及经营布局一致；报告期内，公司产能利用率情况良好，因产品技术迭代导致固定资产整体淘汰报废的风险较小，固定资产不存在减值迹象，未进行减值计提具有合理性；

4、公司持有定期存款的原因系在保障安全性与流动性的前提下提高资金使用效率，具有合理性，随着流动资金需求的增加，报告期末定期存款规模已有所下降。报告期内，公司利息收入与存款规模相匹配，定期存款不存在质押、冻结、隐形担保等受限或被占用情形；

5、自本次发行董事会决议日前六个月起至本问询回复出具日，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资情况；截至报告期末，公司不存在财务性投资，满

足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求。

（本页无正文，为上会会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》之签章页）

签字注册会计师：


耿磊


耿磊


周思艺


周思艺

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年9月30日